# 13.1

# Влияние температуры роста на физико-химические свойства слоев низкотемпературного GaAs, созданных методом импульсного лазерного напыления

© Р.Н. Крюков, Ю.А. Данилов, В.П. Лесников, О.В. Вихрова, С.Ю. Зубков

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия E-mail: kriukov.ruslan@yandex.ru

Поступило в Редакцию 21 сентября 2022 г. В окончательной редакции 12 декабря 2022 г. Принято к публикации 12 декабря 2022 г.

Методом импульсного лазерного напыления получены слои низкотемпературного GaAs приборного качества с высоким удельным сопротивлением. Свойства слоев GaAs чувствительны к температуре процесса. При температуре роста менее  $300^{\circ}$ C слои характеризуются низкими значениями подвижности электронов и смещением стехиометрии GaAs в область обогащения мышьяком на уровне 1-2 at.%. При температуре выращивания более  $300^{\circ}$ C слои показывают улучшенное кристаллическое качество. Зависимость относительной интенсивности фотоэлектронной линии As 3d от температуры роста подтверждает указанную тенденцию с изменением температуры роста.

Ключевые слова: импульсное лазерное нанесение, эффект Холла, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.

DOI: 10.21883/PJTF.2023.04.54519.19372

Процесс выращивания слоев GaAs при пониженной температуре (low temperature, LT-GaAs) известен с 80-х годов прошлого века [1]. Для формирования LT-GaAs используется практически исключительно молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ), при этом в ростовой камере обеспечивается избыточная подача мышьяка [2]. Результатом избытка As в выращенных слоях считают низкое время жизни неравновесных носителей заряда и высокое удельное сопротивление [3]. Эти свойства обеспечили ряд важных приложений LT-GaAs, в частности, в генераторах и детекторах терагерцевого излучения [4], сверхбыстрых фотоприемниках [5]. Также известно использование таких слоев в технологии, например, в качестве дислокационных фильтров для выращивания гетероструктур GaAs/Si [6] и покровных слоев для структур с квантовыми точками [7].

Известны немногочисленные работы по LT-GaAs, полученному методом эпитаксии с использованием металлоорганических соединений [8,9]. Однако отнести этот метод к низкотемпературному выращиванию GaAs можно лишь довольно условно, поскольку при снижении температуры подложки (T<sub>s</sub>) скорость роста резко снижается (например, до 0.05 nm/s при 445°C и до нуля при 400°C [8]) из-за падения скорости разложения триметилгаллия. Кроме того, при уменьшении T<sub>s</sub> увеличивается концентрация неконтролируемых акцепторов (углерода) в слоях [8]. Указанных сложностей лишен метод импульсного лазерного напыления (ИЛН) в вакууме, в котором скорость нанесения распыляемого материала мало зависит от  $T_s$ . И хотя метод ИЛН успешно используется для формирования сильнолегированных примесями переходных элементов (Fe) ферромагнитных

слоев GaAs [10], свойства нелегированного арсенида галлия при использовании этого метода не изучены.

Для выращивания слоев LT-GaAs использовалась установка собственной разработки, представляющая собой цилиндрическую вакуумную камеру из нержавеющей стали, снабженную входным кварцевым окном для ввода лазерного излучения. Базовое давление в камере составляло  $7 \cdot 10^{-5} - 10^{-4}$  Ра. Расстояние между вращающейся мишенью и подложкой составляло около 8 ст. В качестве мишени использовался нелегированный GaAs. Излучение импульсного Nd:YAG-лазера (марки LQ-529), работающего на второй гармонике (длина волны 532 nm, энергия импульса  $\sim 250 \, \text{mJ}$ , длительность импульса 10 ns), фокусировалось на мишени в пятно размером  $\sim 1.5 \,\mathrm{mm^2}$ . Частота повторения импульсов составляла 10 Hz. Подложки полуизолирующего GaAs(100) (epi-ready) непосредственно перед загрузкой обрабатывались в растворе HF:H<sub>2</sub>O=1:10 для удаления естественного окисла, а в ростовой камере перед началом процесса выращивания проходили термообработку при 400°С в течение 30 min. Напыление слоев LT-GaAs производилось в течение 25 min при  $T_s = 60-450^{\circ}$ C со скоростью роста  $\sim 2 \, \text{nm/min.}$ 

На структурах проводилось измерение электрических параметров с использованием эффекта Холла (установка Nanometrics HL5500). Исследования образцов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) выполнялись на комплексе Omicron Multiprobe RM (Omicron Nanotechnology GmbH, Германия). Для возбуждения эмиссии фотоэлектронов использовалось Mg $K_{\alpha}$ -излучение (1253.6 eV). При проведении эксперимента записывались фотоэлектронные линии O 1s, C 1s, **Рис. 1.** АСМ-изображение поверхности слоя LT-GaAs, выращенного при  $T_s = 150^{\circ}$ С.

As 3d и Ga 3d. Глубина анализа при этом составляла  $3\lambda \sim 5$  nm. Значение  $\lambda$  (глубина свободного пробега фотоэлектрона) вычислено по методике, описанной в [11]. Диаметр области анализа составлял 3 mm. В камере удерживалось давление остаточных газов 5 · 10<sup>-7</sup> Ра. Послойное профилирование осуществлялось травлением ионами Ar<sup>+</sup> с энергией 1 kV. При проведении этой процедуры давление в камере составляло 4 · 10<sup>-4</sup> Ра. Угол между осью ионной пушки и нормалью к поверхности образца составлял 45°. Ионный ток, зарегистрированный на образце при травлении, составлял 3.8 µА. Температура образца при проведении всего эксперимента не превышала 50-60°С. Спектральный анализ осуществлялся с использованием программных пакетов SDP v. 4.3 и CasaXPS по алгоритму коррекции спектров, описанному в [12].

С использованием атомно-силового микроскопа (ACM) Solver Pro (НТ-МДТ, Россия) были проведены исследования поверхности слоев (рис. 1). Шероховатость (среднеквадратичное отклонение RMS) поверхности слоев после роста составляла 0.1–0.2 nm. Анализ топографии поверхности после ионного травления показал, что при использованных режимах профилирования значительной модификации не происходило.

Из измерений эффекта Холла следует, что поверхностное сопротивление (R) структуры LT-GaAs/подложка несколько уменьшается по сравнению с  $R_s$  для подложки без выращенного слоя ( $5.4 \cdot 10^9 \Omega$ /sq). Как подложка, так и LT-GaAs показали *n*-тип проводимости. Расчет сопротивления слоя LT-GaAs ( $R_1$ ) проводился по

двухслойной модели [13]:

μ

$$R_1 = RR_s/(R_s-R),$$
1 =  $(\mu - \mu_s/(1+eta^{-1}))(1+eta)$  при  $eta = R_1/R_s$ 

где  $R_1$  — сопротивление слоя,  $R_s$  — сопротивление подложки, R — измеренное с использованием эффекта Холла сопротивление структуры,  $\mu_1$  — эффективная подвижность электронов в слое,  $\mu$  — измеренное значение подвижности,  $\mu_s$  — подвижность носителей заряда в подложке (4810 cm<sup>2</sup>/(V · s)). Результаты расчета представлены на рис. 2 для различных температур выращивания. Удельное сопротивление LT-GaAs (5 · 10<sup>3</sup> – 4 · 10<sup>4</sup>  $\Omega$  · cm) сравнимо со значениями, полученными в методе МЛЭ [2].

Подвижность электронов в слоях LT-GaAs, выращенных при температурах ниже 250°С, составляла ~  $20 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ . При  $T_s = 300$ °С и выше наблюдается резкое увеличение этого параметра, после чего величина стремится к значению подвижности, характерному для подложки (рис. 2). Вид зависимости  $R_1(T_s)$  (рис. 2) позволяет говорить, что температура  $T_s = 300$ °С является критической. Выращивание при более высокой температуре приводит к увеличению подвижности электронов, вызванному улучшением кристаллического качества слоев, и соответствующему снижению слоевого сопротивления.

Анализ профилей распределения Ga и As, примеры которых представлены на рис. 3, *а* и *b*, позволяет утверждать, что слои, выращенные при  $T_s < 300^{\circ}$ С, имеют неоднородный состав по глубине. Независимо от  $T_s$  приповерхностные слои (до глубин ~ 10 nm) обогащены As. Вблизи границы раздела LT-GaAs/GaAs наблюдаются заметные флуктуации концентрации Ga и As. Спектры фотоэлектронной линии As 3*d*, записанные при исследовании слоев LT-GaAs, выращенных при температурах ниже 150°С (рис. 3, *c*), аппроксимированы тремя компонентами: основная при 41.5 eV (As–Ga), компонента с химическим сдвигом +0.9 eV (ассоциируется с элементным As<sup>0</sup> [14]) и компонента со сдвигом









**Рис. 3.** *а* — профили распределения химических элементов по глубине в структуре LT-GaAs/GaAs, выращенной при температуре  $350^{\circ}$ C. *b* — профили распределения атомов Ga и As в структурах LT-GaAs/GaAs, созданных при  $T_s = 60$ , 150 и  $300^{\circ}$ C. *c* — спектральное разложение фотоэлектронной линии As 3*d*, записанной при анализе слоя LT-GaAs, выращенного при  $60^{\circ}$ C. Толщина стравленного слоя составляет 13 nm (точки — экспериментальные данные, серая кривая — сумма спектральных компонент). *d* — изменение отношения интенсивностей фотоэлектронной линии As 3*d* и фона, зарегистрированного при энергии связи 15 eV. При регистрации сигнала ось анализатора была параллельна нормали к поверхности образца.

-0.5 eV (димеры As-As [14]). Можно предположить, что в качестве элементного As<sup>0</sup> регистрируется мышьяк, находящийся в кластерах, или атомы As в междоузлиях. Для LT-GaAs, выращенного пр 60°С, суммарное содержание As<sup>0</sup> и As<sub>dim</sub> на глубине 10–20 nm от поверхности слоя составляет 1.5 at.%. При  $T_s > 150$ °C это значение составляет менее 0.5 at.%, что сопоставимо с погрешностью измерений методом РФЭС.

В ходе анализа фотоэлектронных спектров была выявлена зависимость относительной интенсивности линии As 3d от  $T_s$  (рис. 3, d). Причиной этого является существование пространственной анизотропии эмиссии фотоэлектронов [15]. Вид зависимости отношения интенсивностей фотоэлектронной линии I(As 3d) и фона I(15 eV) от  $T_s$  косвенно указывает на незначительное изменение кристаллического качества при  $T_s = 60-250^{\circ}$ С. При  $T_s > 300^{\circ}$ С слой по свойствам стремится к характеристикам подложки.

Таким образом, импульсное лазерное напыление может быть использовано для получения высокоомных слоев LT-GaAs, пригодных для создания полупроводниковых приборов. Температура подложки при выращивании является важным параметром. При  $T_s$  меньше  $300^{\circ}$ C в слоях наблюдаются неоднородности химического состава и невысокое кристаллическое качество. При увеличении температуры роста выше  $300^{\circ}$ C подвижность электронов в слоях стремится к значениям выше  $3000 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ , что связано с улучшением кристаллического качества.

## Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-265.2022.1.2. Исследования электрических свойств проведены в рамках проекта РНФ № 23-29-00312.

### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

# Список литературы

- Y. Horikoshi, M. Kawashima, H. Yamaguchi, Jpn. J. Appl. Phys., 25 (10), L868 (1986). DOI: 10.1143/JJAP.25.L868
- [2] Н.А. Берт, А.И. Вейнгер, М.Д. Вилисова, С.И. Голощапов, И.В. Ивонин, С.В. Козырев, А.Е. Куницын, Л.Г. Лаврентьева, Д.И. Лубышев, В.В. Преображенский, Б.Р. Семягин, В.В. Третьяков, В.В. Чалдышев, М.П. Якубеня, ФТТ, 35 (10), 2609 (1993).
- [3] А.А. Пастор, П.Ю. Сердобинцев, В.В. Чалдышев, ФТП,
   46 (5), 637 (2012). [А.А. Pastor, Р.Yu. Serdobintsev,
   V.V. Chaldyshev, Semiconductors, 46 (5), 619 (2012).
   DOI: 10.1134/S106378261205017X].
- [4] А.А. Горбацевич, В.И. Егоркин, И.П. Казаков, О.А. Клименко, А.Ю. Клоков, Ю.А. Митягин, В.Н. Мурзин, С.А. Савинов, В.А. Цветков, Крат. сообщ. по физике ФИАН, 42 (5), 3 (2015). [А.А. Gorbatsevich, V.I. Egorkin, I.P. Kazakov, O.A. Klimenko, A.Yu. Klokov, Yu.A. Mityagin, V.N. Murzin, S.A. Savinov, V.A. Tsvetkov, Bull. Lebedev Phys. Inst., 42 (5), 121 (2015).
  - DOI: 10.3103/S1068335615050012].
- [5] C. Tannoury, M. Billet, C. Coinon, J.-F. Lampin, E. Peytavit, Electron. Lett., 56 (17), 897 (2020).
   DOI: 10.1109/IRMMW-THz46771.2020.9370757
- [6] Д.С. Абрамкин, М.О. Петрушков, Е.А. Емельянов, М.А. Путято, Б.Р. Семягин, А.В. Васев, М.Ю. Есин, И.Д. Лошкарев, А.К. Гутаковский, В.В. Преображенский, Т.С. Шамирзаев, Автометрия, 54 (2), 85 (2018). DOI: 10.15372/AUT20180210 [D.S. Abramkin, M.O. Petrushkov, E.A. Emel'yanov, M.A. Putyato, B.R. Semyagin, A.V. Vasev, M.Yu. Esin, I.D. Loshkarev, A.K. Gutakovskii, V.V. Preobrazhenskii, T.S. Shamirzaev, Optoelectron. Instrum. Proc., 54 (2), 181 (2018). DOI: 10.3103/S8756699018020103].
- [7] В.Н. Неведомский, Н.А. Берт, В.В. Чалдышев, В.В. Преображенский, М.А. Путято, Б.Р. Семягин, ФТП, 43 (12), 1662 (2009).
  [V.N. Nevedomskii, N.A. Bert, V.V. Chaldyshev, V.V. Preobrazhenskii, М.А. Putyato, B.R. Semyagin, Semiconductors, 43 (12), 1617 (2009).
  DOI: 10.1134/S1063782609120082].
- [8] H. Sakaguchi, T. Mishima, T. Meguro, Y. Fujiwara, J. Phys.: Conf. Ser., 165, 012024 (2009).
   DOI: 10.1088/1742-6596/165/1/012024
- [9] I. Demir, A.E. Kasapoğlu, H.F. Budak, E. Gür, S. Elagoz, Eur. Phys. J. Appl. Phys., **90** (2), 20301 (2020).
   DOI: 10.1051/epjap/2020190216
- [10] A.V. Kudrin, V.P. Lesnikov, Yu.A. Danilov, M.V. Dorokhin, O.V. Vikhrova, P.B. Demina, D.A. Pavlov, Yu.V. Usov, V.E. Milin, Yu.M. Kuznetsov, R.N. Kriukov, A.A. Konakov, N.Yu. Tabachkova, Semicond. Sci. Technol., **35** (12), 125032 (2020). DOI: 10.1088/1361-6641/abbd5c
- [11] M.P. Seah, W.A. Dench, Surf. Interface Anal., 1 (1), 2 (1979). DOI: 10.1002/sia.740010102
- [12] A.V. Boryakov, S.I. Surodin, R.N. Kryukov, D.E. Nikolichev, S.Yu. Zubkov, J. Electron Spectr. Relat. Phenom., 229, 132 (2018). DOI: 10.1016/j.elspec.2017.11.004
- [13] Е.В. Кучис, Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования (Радио и связь, М., 1990), с. 52–55.
- [14] M.V. Lebedev, E. Mankel, T. Mayer, W. Jaegermann, J. Phys. Chem. C, 114 (49), 21385 (2010). DOI: 10.1021/jp104321e
- S. Hofmann, Auger- and X-ray photoelectron spectroscopy in materials science (Springer, Berlin, 2013), p. 30–62. DOI: 10.1007/978-3-642-27381-0